

【原因・判断ポイント・発生工程】FPCのプレス打ち抜き外形加工の際製品の上に異物が介在したためプレス圧により出来たもの（プレス打ち抜き加工工程）

【原因、判断要点、発生工序】FPC 冲切外形時、产品上夹杂杂物就冲切所引起的（冲切工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】  
The dent is caused by pressing a foreign object on a FPC against the coverlay in punching process. (Blanking process)



【コメント】  
FPC  
顕微鏡倍率 ×

【注釋】  
FPC  
显微镜倍率 ×

【Comments】  
FPC  
Magnification: ×



【コメント】  
FPC  
顕微鏡倍率 ×

【注釋】  
FPC  
显微镜倍率 ×

【Comments】  
FPC  
Magnification: ×

【コメント】  
FPC  
顕微鏡倍率 ×

【注釋】  
FPC  
显微镜倍率 ×

【Comments】  
FPC  
Magnification: ×

## 2-1-2-6 アルミ基板 SR 打痕／铝基板的 SR 压痕／Dent on solder resist on aluminum-base printed board

【特徴】SR 表面に凹み状の衝突打痕が残されている状態の欠陥であるが、アルミ材料そのものにまで変形が及んでいるもの

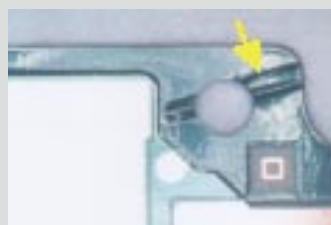
【特征】在 SR 表面有凹陷的冲击压痕的缺陷，造成铝基板自身的变形。

【Characteristics】A dent caused by an impact is left on the solder resist surface. The deformation reaches to the aluminum base itself.

【原因・判断ポイント・発生工程】SR 塗布乾燥後のハンドリング作業時に、不注意に何かにぶついたり、異物を挟み込んで荷重を掛けたりして出来たもの（SR 塗布乾燥後工程）

【原因、判断要点、发生工序】在 SR 涂布干燥后的搬运作业时，不小心碰撞或者夹杂杂物，负荷加重而引起的（SR 涂布干燥后工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】  
The solder resist surface is carelessly hit by some object, or a foreign object is pressed on the surface with a load during handling after solder resist coating and curing. (After solder resist coating and curing process)



【コメント】  
顕微鏡倍率 ×

【注釋】  
显微镜倍率 ×

【Comments】  
Magnification: ×



【コメント】  
顕微鏡倍率 ×

【注釋】  
显微镜倍率 ×

【Comments】  
Magnification: ×